

## 일본 전자부품업체 중국시장 진출 동향

'94년 일본 전자부품업체의 중국에서의 생산강화 움직임이 계속되고 있다. 이미 현지 생산에 착수하고 있는 제조 거점에서 신공장의 건설, 위탁가공방식에 의한 합작과 독자적인 투자에 의한 본격적인 공장진출, 생산품목의 다양화 등, 이러한 구상이 실시되는 금년 후반부터 '95년 전반에 걸쳐 총생산능력이 대폭적으로 확충될 것으로 보인다.

또한 가격경쟁력을 의식한 전략이 그 배경에 있으나, 메이커에 따라서는 부자재에서부터 일괄 생산체제의 정비를 예정하고 있는 곳도 많아, 태국, 말레이시아 등의 ASEAN지역과 함께 세계의 부품생산 공급 거점이 될 시기가 상당히 빠르게 다가올 것으로 예상되고 있다.

이제까지 중국에서의 전자부품 생산을 행하려 하고 있는 기업 수는 계획중인 것까지 포함해, 주요 기업만으로도 대략 40개사에 이르고 있다.

이들 기업의 내용을 살펴보아도 반도체 디바이스에서 회로부품, 접속부품, 변환부품까지 다양하며, 대상이 되는 세트 시장도 AV(음향, 영상)기기에 머물지 않고 정보통신기기에까지 미치고 있다.

현시점과 비교해, 1년 혹은 2년후에 생산능력이 어느정도까지 상승할 것인가는 한마디로는 말할 수 없지만, 이제부터 본격적으로 중국에서의 생산을 강화하겠다는 기업도 있어 20~30%의 증가는 충분히 달성될 것으로 보인다.

특히 스위치와 소형모터, 자기헤드라고 하는

부품, 더욱이 VTR과 비디오용 튜너 등은 진출기업의 중기계획으로 봐서 상당한 폭이 될 것이다.

회로부품 메이커의 경우도 중국을 대상으로 한 생산강화의 움직임은 중장기적으로 현지의 시장이 확대할 것에 대비하는 한편, 수출거점으로써의 가격경쟁력 강화를 노리고 있다고 말할 수 있다.

특히 코일, 트랜스와 같은 노동집약적 요소가 강한 권선응용부품에 대해서는, 대형메이커 뿐만아니라, 중견기업까지 중국생산에 착수. 이미 「중국생산이 양적으로 최대거점」(스미다 전기, 기타)으로써 구축한 기업도 적지 않다. 진출형태도 위탁가공이 여전히 많지만 합작사업과 전액출자로 스타일이 변화하고 있는 것도 특징이다.

또한 생산품목도 알프스전기, KOA가 저항기의 양산을 개시한 것외에 대막공이 수정진동자로 최근 조업을 개시하고, 일본 전과공업도 '95년 4월을 목표로 조업하는 등 수정제품에까지 확대하고 있다.

현재, 콘덴서는 일부 기업에 한정되어 있으나, 동광은 세라믹 필터까지 품목을 확충하였고 또 트랜스의 현지 생산을 전개하고 있는 메이커중에는 웨라이트코어의 본격적인 진출검토가 시작된 외에 스위칭 전원의 조립까지 행하는 메이커도 등장하였다.

한편, 전자부품 메이커의 중국진출은 금월 2일에 무라다제작소가 북경에 합작공장을 세우고, 금년 후반부터 칩 적층세라믹 콘덴서의 생

산을 개시한다고 발표해, 이제 거의 모든 주요 전자부품 메이커가 진출한 것이 되었다.

가장 오래된 것은 산요전기가 '83년에 전액 출자로 설립한 산요전기 사구로, 스피커, 모터, 프린터기판의 생산 및 하네스를 행하고 있다.

'86년에는 일본 세라믹이 합작으로 적외선 센서의 생산을 개시한 바 있으며, '87년에는 마쓰시다 전기공업이 합작으로 칼라TV의 브라운관 공장을 가동시켰고, '88년에는 호시텐이 기구부품, 전자부품의 생산과 코드 어셈블리를 위탁생산하고 있다.

'90년대에 들어서는 중국에의 공장진출이 본격화하여, '91년에 일본 세라믹이 합작으로 웨라이트의 생산을 개시하였으며, '92년에는 마쓰시다전자부품이 자동차의 생산공정에서 나오는 것들을 재활용할 수 있도록 위탁한 바 있다.

'93년에는 산요전기의 협력회사인 썬 전자공업이 소형 알루미늄 전해 콘덴서의 생산을 위탁하였으며, 호시텐이 화남에서 액정의 위탁 생산을 본격화시켰다.

전연전기가 한국자회사의 트랜스 위탁생산에 이어 화남에서 트랜스, 전원의 위탁 생산을 개시하였으며, 마쓰시다 전기정보기기 모터사업부가 전액출자로 오디오용 소형모터의 생산을 시작하였다.

금년에도 1월에 마쓰시다전기가 합작으로 VTR용 기간부품의 생산을 개시하였으며, 마쓰시다 전자부품도 2월 중순부터 하순에 걸쳐, 전자튜너, 데모플레이타, 리모콘의 생산을 시작한다. 또 금년 가을에는 로음이 합작으로 액정 모듈, 프린트 헤드, 하이브리드 IC의 생산을 개시할 예정이다.

